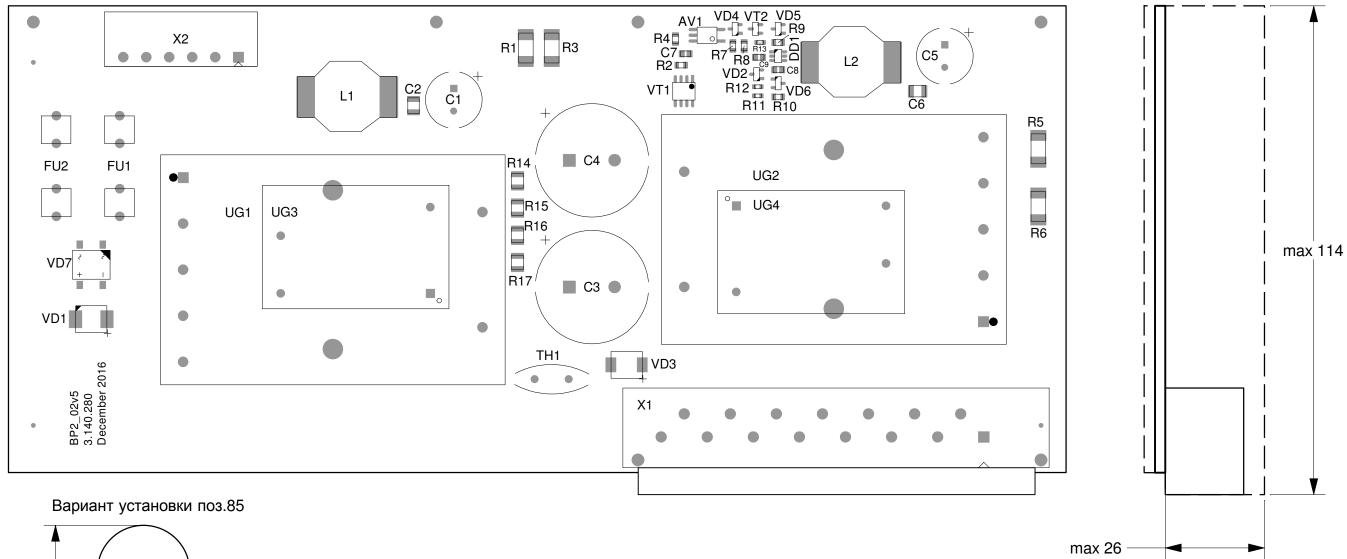
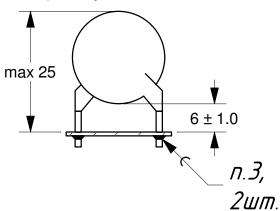
9J E19'071'Z





- 1. * Размеры для справок.
- 2. Покрытие платы HASL.

						2.140.613 СБ					
İ	2						//	Тит		Масса	Масштаδ
. [Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	5 555 55					
	Разраб.		Щеблыкин М.		07.12.16	Плата BP2_02v5					
	Проц	верил	Вершинин А		07.12.16	,,,, <u>a</u> ,,, <u>a</u>	////a///a b/ 2_02 / 5				
	Т. контр.						ТП		Листов	1	
	Н. контр. Назаренко А.			07.12.16			000	"При	ософт-Си	ІСТЕМЫ"	
I	ЧтР	3	<i>Υυρκοβ ΔΓ</i>					, ,			

- 3 Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
- 4. Требование к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610F.
- 5. Элементы поз.31,33,43,45,55,57,59 устанавливать до упора в плату.
- 6. Для элементов поз.51 запаять по два держателя поз.51.
- 7. Остальные TT по ОСТ4 ГО.070.015.

Nº	Наименование	Корпус	Кол.	Поз.	Примечание
1	Сборочный чертеж				
	2.140.613 rev.0		1		
	ДЕТАЛИ				
3	Плата печатная 3.140.280 BP2_02v5		1		
	3.1+0.200 B/ 2_02V3		_		
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ				
	TIPO VIL VISALINIA				
	<u>Диоды</u>				
		20.0441			
9	1.5SMC400A SMC Littelfuse	DO-214AB	1	VD1	
11	BZX84C4V7	S0T23-3	3	VD2,VD5,VD6	
13	BZX84C15	S0T23-3	1	VD4	
15	DF10S D-71 MOCM	SMD-4	1	VD7	
15	DF103 D-71 MOCIII	3MD-4	1	VD7	
17	S3M SMC	DO-214AB	1	VD3	
21	Индуктивность SDR2207-4R7ML				
	BOURNS	SMD-2	2	L1,L2	
	<u>Конденсаторы</u>				
25	чип 0805 X7R 50V 0.01uF 10%	0805	2	C8,C9	
			-		
27	чип 0805 X7R 50V 0.1uF 10%	0805	1	C7	
29	чип 1210 X5R 50V 10uF 10%	1210	2	C2,C6	

<u>О</u> Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2.140.613				
Разраб.		Щеблыкин М.В	useof	07.12.16		Лит. Лист Л		Листов	
Проє	зер.	Вершинин А.С.	Be	07.12.16	Drama DD2 02v5	4			
					Плата BP2_02v5	000			
Н.ког	нтр.	Назаренко А.Н.	StoA	07.12.16		"Πnooo	000	2014/ /2	
Утв.	•	Чирков А.Г.	-		Спецификация	«Прософт-Систем		IICIVIDI»	

31	B41858C6227M 470uF 50V 20%				
<i>J</i> 1	EPCOS	LEAD-2	2	C1,C5	
	27 003	LLAD Z			
33	B43501B9107M 100uF 400V 20%				
	EPCOS	LEAD-2	2	C3,C4	
	LFC03	LLAD-Z		(3,04	
	<u> Микросхемы</u>				
	<u>никросхелы</u>				
37	ACPL-M50L-500E SO5 Avago	505	1	AV1	
- 57	ACFE-MODE-DOOL SOO AVUGO	303		AVI	
39	PMA15 S05 MTM Power	DIP-7	1	UG1	Не утсанавл.
39	FMALS SOS MIN FOWER	DIF-7	1	001	пе ушсиниол.
41	PMA15 S24 MTM Power	DIP-7	1	UG2	Не устанавл.
41	FMALS 324 MIN FOWER	DIF-7	1	002	пе устаниол.
43	TMG 15105 TRACO	DIP-4	1	UG3	
43	ING 13103 TRACO	DIP-4	1	003	
45	TMG 15124 TRACO	DIP-4	1	UG4	
45	THE 13124 TRACE	DIF-4	1	004	
47	TPS3702AX33DDC TI	S0T23-6	1	DD1	
47	TP3370ZAX33DDC TI	30123-0	1		
F1					
51	Предохранитель ZH214-030 5*20 Zhenhui Electronics		2	FUI FUI	V
	ZHERINUL ELECTRONICS			FU1,FU2	Уст.при настройке
	Pant own				
	<u>Разъемы</u>				
	221 526 (001 000 1/460	6	1	X2	
55	231-536/001-000 WAGO	D	1	λ2	
	DTN/41C12 000C11E2011 HARTING				
57	DIN41612 09061152911 HARTING	15	1	V1	
	(DIN 41612 15 MR)	15	1	X1	
EO	74266	LEAD 2	1		dag nos E1
59	ZH266	LEAD-2	4		для поз.51
	Pasucmonu				
	<u>Резисторы</u>				
63	чип 0603 2K 1%	0603	1	P13	
0.5	741 Z C 1/6	0603	1	R12	
<u></u>	0602 10V 19	0003	1	D11	
65	чип 0603 10К 1%	0603	1	R11	
67	uun 0502 20V 19	0603	1	D12	
67	чип 0603 20К 1%	0603	1	R13	
ı		1			1

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
0				

		Ī			
	0005 100 5%	0007	_	D4 D0	
69	чип 0805 100 5%	0805	2	R4,R9	
71	чип 0805 1К 5%	0805	1	R7	
73	чип 0805 10K 5%	0805	3	R2,R8,R10	
75	чип 1210 33K 5%	1210	4	R14-R17	
81	Yun 2512 5.1K 5%	2512	4	R1,R3,R5,R6	
				,,	
			_		
85	Термистор JNR15S470L	LEAD-2	1	TH1	
	<u>Транзисторы</u>				
89	IRF7410 IR	SOIC8	1	VT1	
91	IRLML2060 60V 1.2A IR	S0T23-3	1	VT2	
-	TRETTEZOGO GOV 1.2A IN	30123 3		V12	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
0				

Лист регистрции изменений СП

№ Изм.	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	07.12.16		
Исполнени	<u> </u> Я:			

Лист регистрции изменений СБ

№ Изм.	№ замененных (измененных) страниц	Дата ревизии	Краткое содержание и причина внесения изменений	Примечание
0	вновь	07.12.16		

						Лист
0					<i>2.140.613</i>	1
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	211101010	4